

東芝 半導体事業との業務提携強化に向けた協議開始の提案について

ローム株式会社(以下、当社)は、日本産業パートナーズ株式会社(以下、JIP)に対して、当社と株式会社東芝(以下、東芝)の半導体事業との業務提携強化に向けた協議を開始する旨の提案を行いました。

本提案は、具体的な協議を開始するためのものであり、その内容については、JIP及び東芝との間で何らの協議及び合意した事項はございません。また、提案後の見通しについては、現時点で確定したものはございません。

今後、本件に関し、新たに開示すべき事項が発生した場合には、速やかに開示いたします。

1. 提案の背景と目的

半導体産業における国際的な競争環境が激化する中、当社及び東芝の半導体事業が持続的に成長し、企業価値を向上するためには幅広い連携が不可欠です。東芝の半導体事業については当社との親和性も高く、製品ポートフォリオや事業戦略などの面で、様々なシナジーを創出できると認識しております。

両社のさらなる企業価値向上に向け、幅広い協業・提携を協議するべく、本提案を実施したものです。また、今回の提案内容に含めるものではありませんが、将来的には下記の対象事業に関して資本提携も視野に入れた協議を行いたいと考えております。

2. 提案の概要

現在、当社と東芝デバイス&ストレージ株式会社にて進めているパワー半導体の製造連携^(注)に加え、下記の対象事業に関して、技術開発、生産、販売、調達、物流など、あらゆる事業活動における業務提携の強化を目指すもの。

(注)当社及び東芝デバイス&ストレージ株式会社の2023年12月8日付ニュースリリース『ロームと東芝デバイス&ストレージが共同で進める「パワー半導体の供給確保計画」が経済産業省より認定』をご参照ください。

3. 対象事業

当社及び東芝のパワー半導体を中心とした半導体事業全般。